

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：981)

關於終止美國預託證券一級計劃公告

中芯國際集成電路製造有限公司（「本公司」）今日宣布，其美國預託證券（「美國預託證券」）的一級計劃（「該計劃」），截至 2021 年 1 月 29 日 (美國東部時間)已發行在外的美國預託證券佔本公司已發行股本總數已少於 0.3%，該計劃參與程度已很低，本公司決定終止該計劃。根據與該計劃有關的存託協議（「存託協議」）條款，該計劃將於 2021 年 3 月 4 日(美國東部時間)終止。

本公司已根據存託協議的條款向存託人摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）（「存託人」）發出終止通知。存託人將直接就終止存託協議和該計劃之手續及影響與美國預託證券的持有人聯繫。

承董事會命

中芯國際集成電路製造有限公司
執行董事、首席財務官兼公司秘書
高永崗

中國上海，2021年1月31日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學（董事長）

蔣尚義（副董事長）

趙海軍（聯合首席執行官）

梁孟松（聯合首席執行官）

高永崗（首席財務官兼公司秘書）

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor Brown

劉遵義

范仁達

楊光磊

* 僅供識別